

# LPWWG63C

## 产品特性 Product Features:

芯片尺寸 Dimensions : 63mil x 63mil  
(1575±50μm x 1575±50μm)

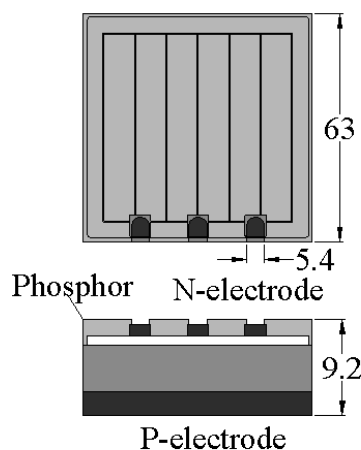
芯片厚度 Chip Thickness :  
9.2mil(230±20μm)

焊盘尺寸 Pad Size : 5.4mil(135±10μm)

焊盘金属 Pad Material :

N 电极 (N PAD) : Au

P 电极 (P PAD) : Au



单位: mil

## 光电性能 (Electronic Parameters), TA=25°C , If=350mA

参数 Parameters	符号 Symbol	条件 Condition	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
开启电压 Turn-On Voltage	Vf1	If=10μA	1.7	---	2.8	V
工作电压 Forward Voltage	Vf2	If=350mA	2.6	2.8	3.1	V
反向漏电流 Reverse Leakage Current	IR	Vr=5V	---	---	1	μA
光通量 Luminous Flux	Φ	If=350mA	110	140	200	lm